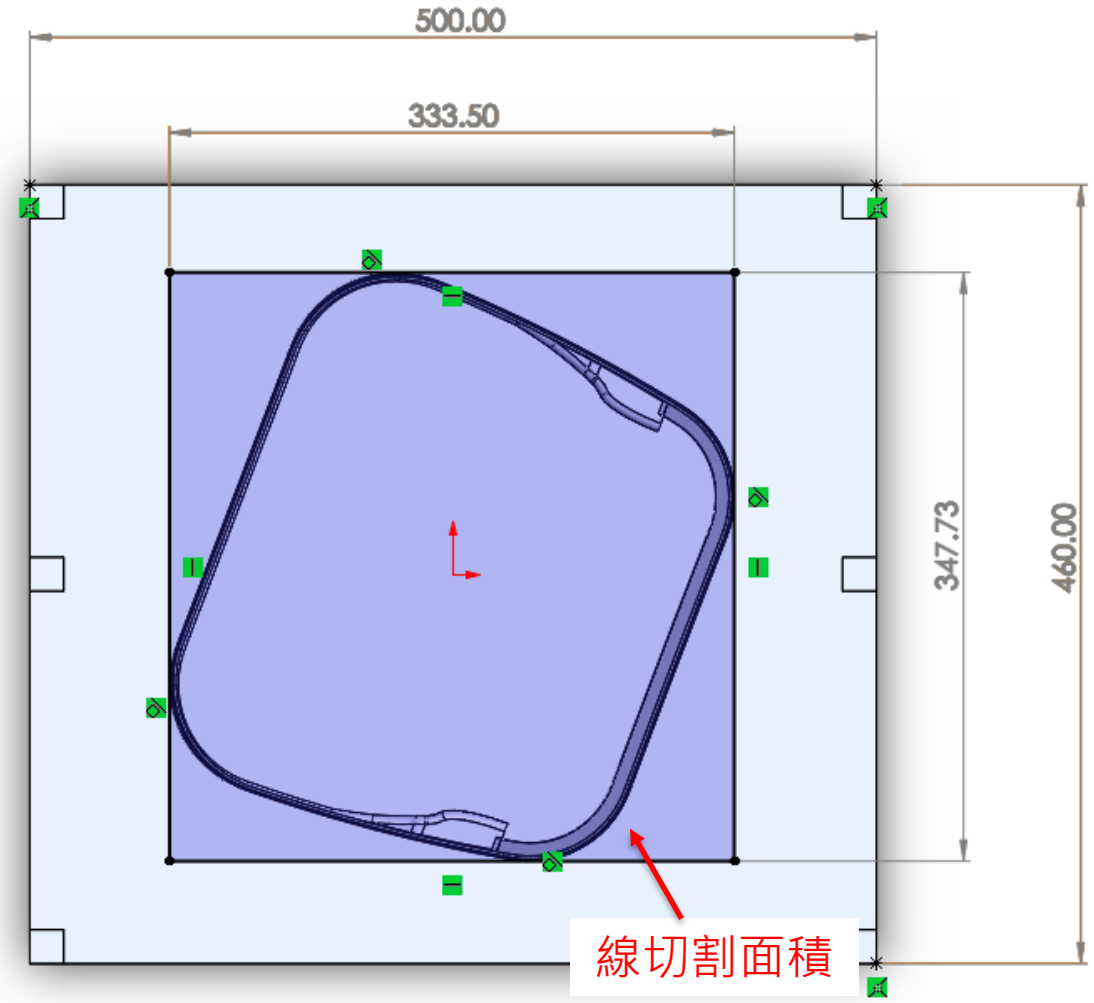
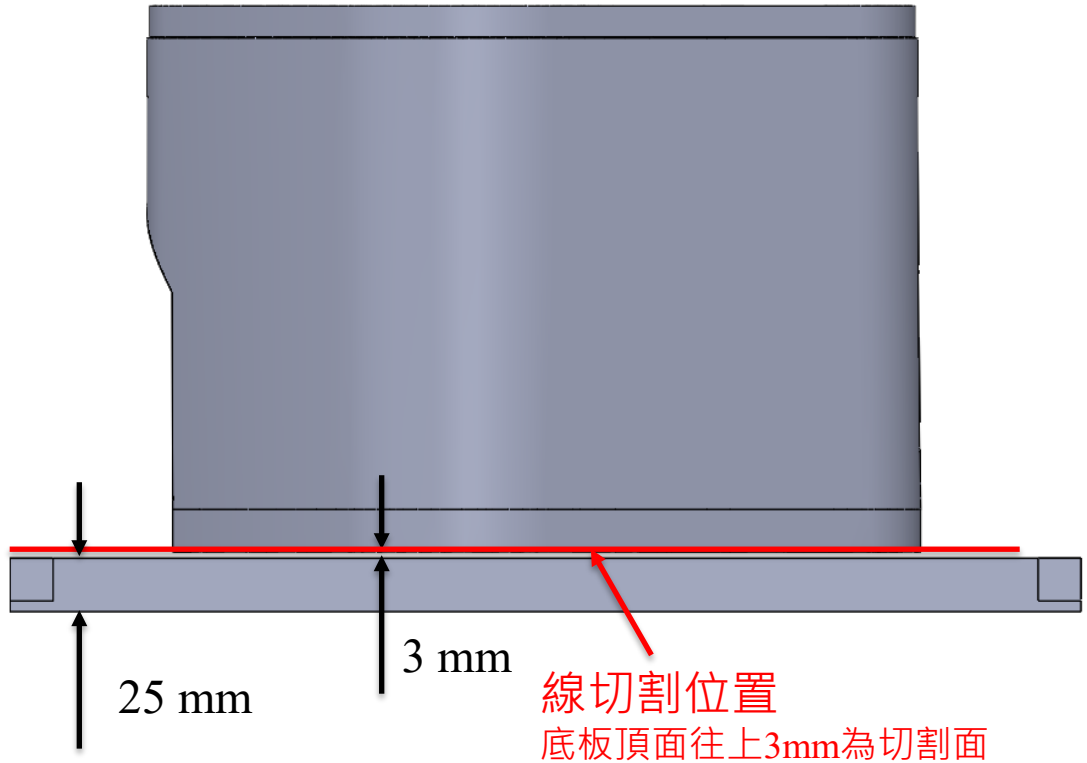
線切割 – 工件1 (FC Seg01)

1. 後加工數量：1 件 (pcs)
2. 需使用線切割工具加工處理
3. 由底板往上 3 mm 切除工件
4. 切割高度公差：+0mm /-0.2mm (嚴禁切入底板頂面與工件)



俯視圖



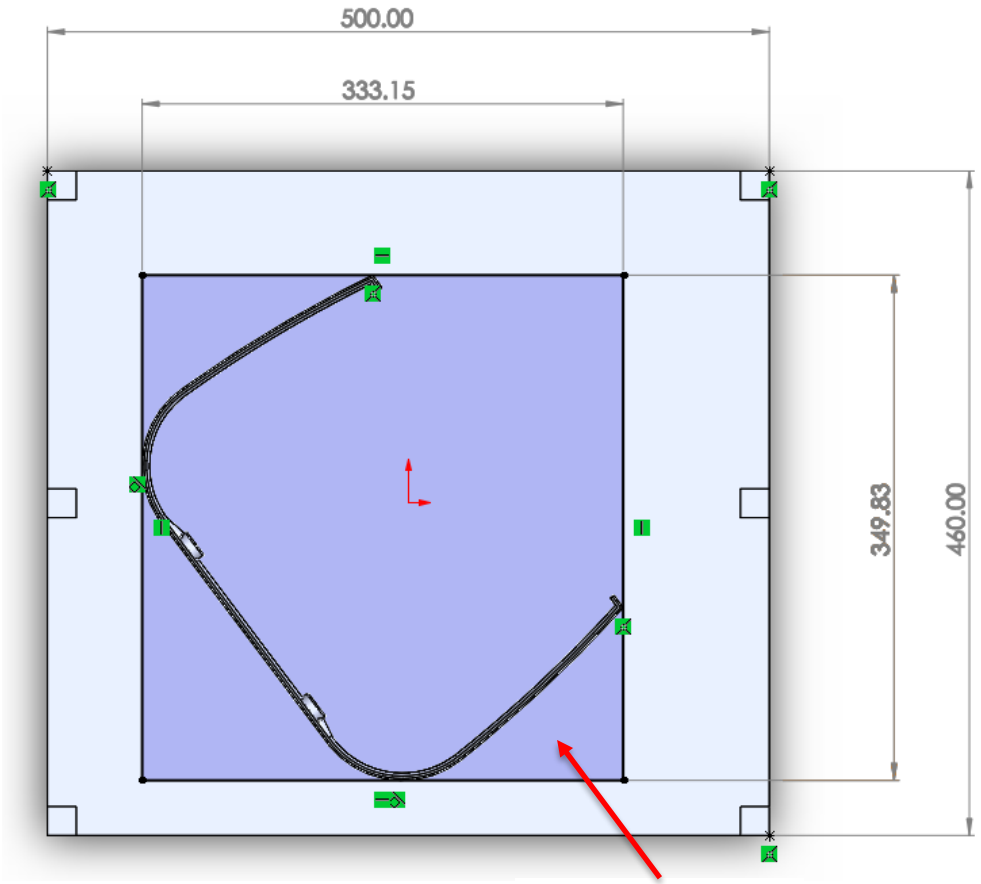
前視圖

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

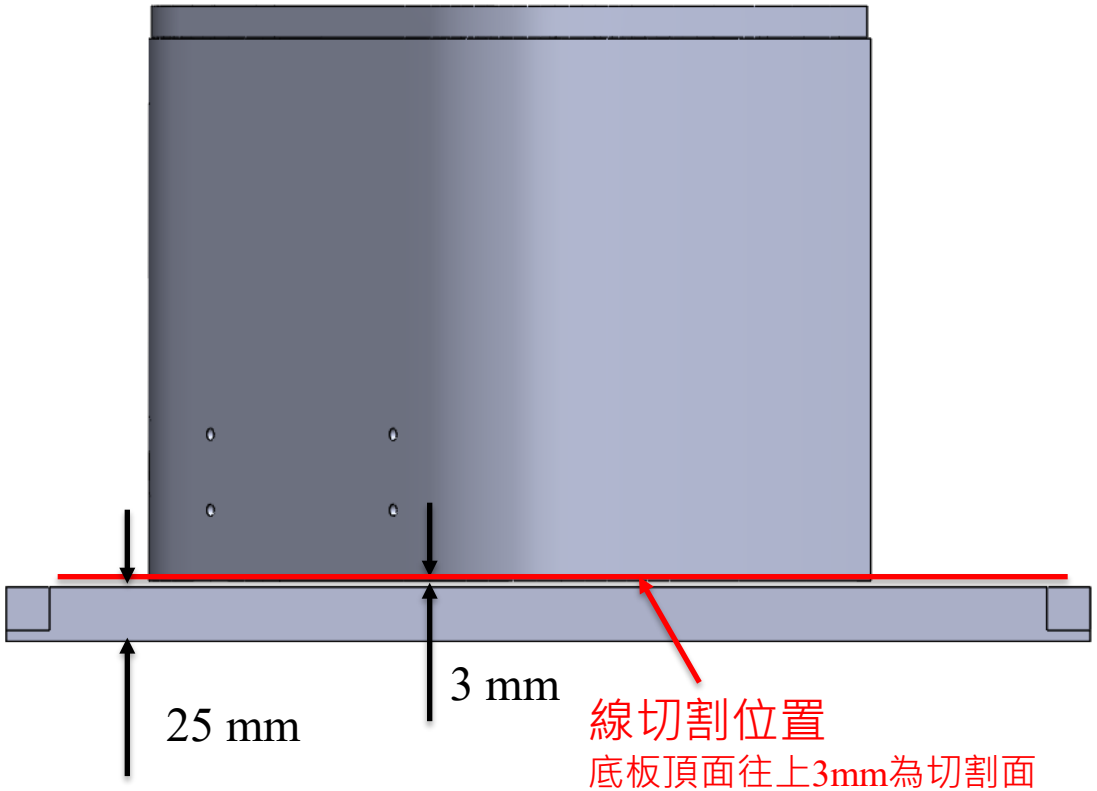
工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

線切割 – 工件2 (FC Seg02)

1. 後加工數量：1 件 (pcs)
2. 需使用線切割工具加工處理
3. 由底板往上 3 mm 切除工件
4. 切割高度公差：+0mm /-0.2mm (嚴禁切入底板頂面與工件)



俯視圖　線切割面積

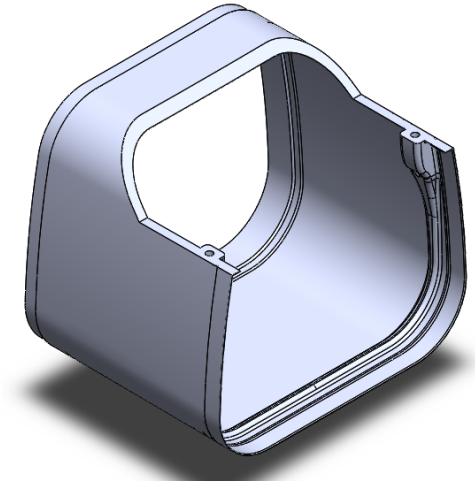


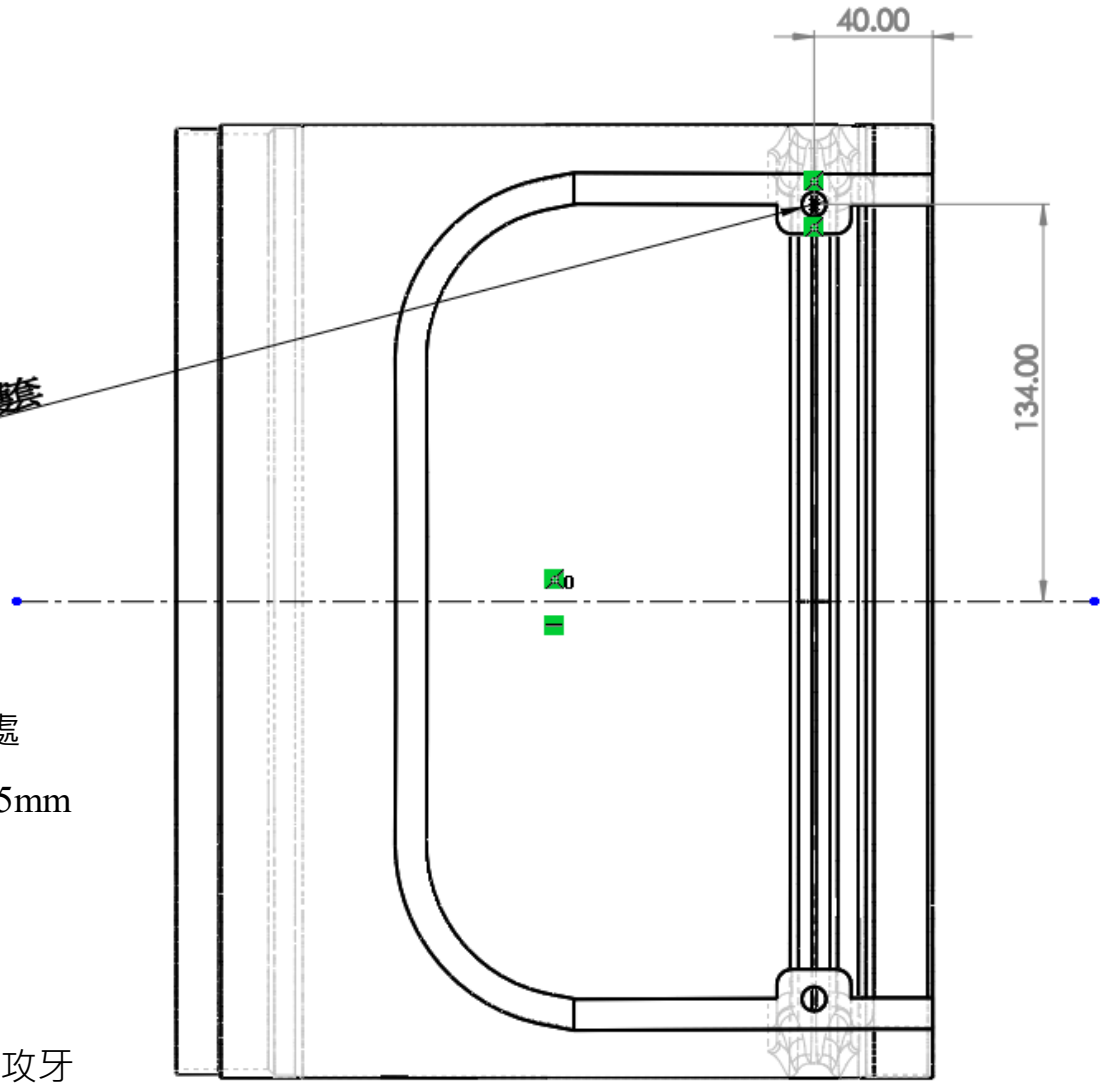
前視圖

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

工件加工 – 通孔及攻牙 (FC Seg01)





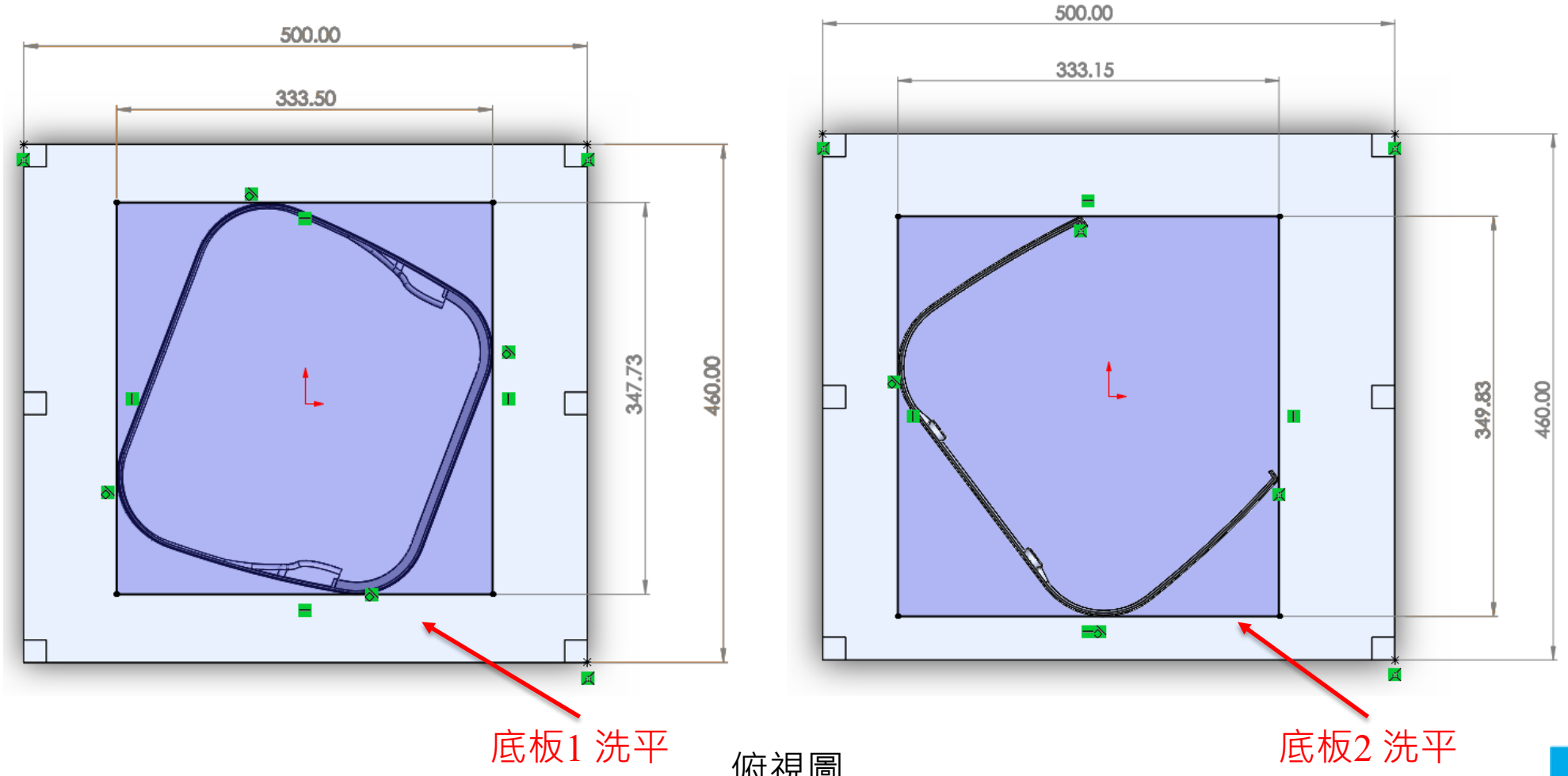
1. 通孔加工直徑： Φ8.3mm 貫穿孔 (THRU) 共兩處
2. 孔位相對尺寸精度：位置度公差需控制於 ±0.05mm 內
3. 螺紋護套安裝規格：M8*1.25*1.5D (Helicoil / Recoil) 共兩處
4. 需採用符合規範之專用螺紋護套絲攻 (STI Tap) 攻牙

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

底板洗平

1. 銑平工件：底板1與底板2
2. 底板表面銑平：全區域平面度需 ≤0.05mm；
   平行度≤0.05mm(頂面相對於底板背面)



俯視圖

工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE